

海通证券股份有限公司

关于佛山市联动科技股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“联动科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山市联动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为96.58元/股，募集资金总额为人民币112,033.23万元，扣除相关发行费用（不含税）10,578.25万元，实际募集资金净额为人民币101,454.99万元。募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZC10346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
----	------	------	---------

1	半导体封装测试设备产业化扩产建设项目	25,250.43	25,250.43
2	半导体封装测试设备研发中心建设项目	25,360.42	25,360.42
3	营销服务网络建设项目	5,000.00	5,000.00
4	补充营运资金	8,156.53	8,156.53
合计		63,767.38	63,767.38

公司于2023年8月11日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司募投项目“营销服务网络建设项目”的实施地点由“西安市、上海市、成都市、中国台湾、马来西亚吉隆坡”变更为“上海市、无锡市、苏州市及华东其他地区；成都市及西南其他地区；华北地区；华中地区；华南地区；马来西亚及海外其他地区”。

截至2024年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	累计投入募集资金	投资进度
1	半导体封装测试设备产业化扩产建设项目	25,250.43	25,250.43	3,912.49	15.49%
2	半导体封装测试设备研发中心建设项目	25,360.42	25,360.42	10,892.03	42.95%
3	营销服务网络建设项目	5,000.00	5,000.00	799.06	15.98%
4	补充营运资金	8,156.53	8,156.53	8,376.86	102.70%（注1）
合计		63,767.38	63,767.38	23,980.44	37.61%

注1：补充营运资金项目投资进度超过100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的情况

（一）部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

根据募投项目实际建设需要，公司研发项目具有创新性，难度大，随着募投项目的持续推进，原计划用于“开发费用-物料费用”的募集资金不足以满足后续项目投入。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司的实际情况，公司拟对募投项目“半导体封装测试设备研发中心建设项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地和安排和调度募投项目的内部投资结构，将部分原用

于“开发费用-人员费用”的募集资金调整至“开发费用-物料费用”，募集资金投资总额保持不变。本次内部投资结构的调整，有利于该项目的具体实施，符合项目建设的实际情况。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额	差额
1	项目投资投资	25,360.42	25,360.42	-
1.1	场地购置及土建工程费	2,192.07	2,192.07	-
1.2	场地装修费	1,045.43	1,045.43	-
1.3	设备购置费	3,921.50	3,921.50	-
1.4	软件购置费	1,421.15	1,421.15	-
1.5	开发费用-人员费用	12,526.26	10,026.26	-2,500.00
	开发费用-物料费用	2,700.00	5,200.00	2,500.00
1.6	场地租赁费	346.37	346.37	-
1.7	基本预备费	1,207.64	1,207.64	-
	合计	25,360.42	25,360.42	-

(二) 募投项目延期的有关情况

1、本次部分募投项目延期的基本情况

基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长部分募投项目的预计可使用状态日期，具体调整如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	半导体封装测试设备产业化扩产建设项目	2024年12月	2026年12月
2	营销服务网络建设项目	2024年12月	2026年12月

2、本次部分募投项目延期的原因说明

(1) 半导体封装测试设备产业化扩产建设项目

公司“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”主要为公司半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备及其他机电一体化设备等主业产品的扩产项目，上述主业产品主要应用于半导体芯片及晶圆的功能和性能测试以及激光打标。

公司专注于半导体行业封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，位于半导体产业的上游。半导体产业处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端

产品得以运行的基础，与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。2021年，随着市场需求呈现爆发性增长，公司产品实现了很好的市场销售。“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”启动后，公司根据市场需求，有序推进项目建设，目前该项目场地土建工程已完工。

但是，在经历了2021年高速增长之后，随着前期扩产产能的逐步释放，半导体行业整体发展基调转变为清理库存，以及受国际环境、全球经济发展滞缓等因素影响，2023年以来，半导体行业在较长一段时间内延续了2022年第四季度以来的下行趋势，终端需求减弱，下游客户对于新增固定资产投资及设备更新的意愿趋于谨慎，致使公司相关产品业务拓展进度不及预期。在此背景下，为了有效控制经营风险，确保募集资金使用能够达到预期效益，故在现有产能产量仍有一定释放空间的情况下，公司出于谨慎性考虑，适当放缓了“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”的建设进度，从而导致募投项目的实际建设进度慢于预期。

进入2024年，随着全球人工智能、高性能运算等需求的爆发增长，以及智能手机、个人计算机为代表的消费电子等市场需求逐渐回暖，新兴应用的推陈出新和技术不断革新，全球半导体行业逐渐回暖，终端需求开始复苏。2024年1-9月，公司实现营业收入22,492.29万元，同比增长33.60%。根据市场需求判断、公司市场定位和行业发展前景，公司持续推进“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”的实施。同时，鉴于全球政治经济形势的不稳定性及市场变化快速，公司在推进项目时，综合考虑市场各因素的变化，审慎进行资金的投入。

鉴于上述原因，同时考虑到全球经济变化、半导体行业周期性波动可能会给项目实施带来的影响，公司拟将“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2026年12月，以更为稳妥地应对市场变化，确保项目的长远发展与投资效益。

（2）营销服务网络建设项目

自“营销服务网络建设项目”启动后，公司根据市场拓展需求，有序推进项目建设。2023年8月，经董事会审议通过，公司根据客户和市场拓展情况，将“营销服务网络建设项目”的实施地点由“西安市、上海市、成都市、中国台湾、马

来西亚吉隆坡”变更为“上海市、无锡市、苏州市及华东其他地区；成都市及西南其他地区；华北地区；华中地区；华南地区；马来西亚及海外其他地区”。

目前公司已在佛山、上海、成都、苏州、无锡等代表性市场区域建立起营销及服务网点。但是，营销及服务网络建设对公司整体业务发展规划和布局影响较大，本着审慎的原则，新的营销及服务网点仍处于实地调研当中，并将针对其具体情况，在确定其可行性后再分别实施。加之近年来经济及行业环境复杂多变，受行业周期性波动影响，新的销售区域拓展步伐变得缓慢，营销服务网络布局亦遭遇了一定的挑战，导致项目建设进度较原计划有所滞后。同时，鉴于全球政治经济形势的不稳定性及市场变化快速，公司在推进项目时，综合考虑市场各因素的变化，审慎进行资金的投入。为了确保项目整体质量，保障募投项目的顺利进行，公司经审慎研究，拟将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月延期至2026年12月，以确保项目在稳健中前行，质量与效率并重。

四、募投项目重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”和“营销服务网络建设项目”进行了重新论证。

（一）半导体封装测试设备产业化扩产建设项目

1、项目必要性

（1）紧跟行业发展步伐，增强竞争实力和盈利能力

在行业周期性波动的影响下，半导体行业可能会遭遇阶段性发展放缓，但从长期来看，随着全球人工智能、高性能运算等需求的迅猛增长，AI技术在终端应用领域的快速部署，相关产品AI功能及技术的持续升级，以及智能手机、个人计算机、服务器及汽车市场的需求正在复苏，加上国内半导体领域的自主创新和技术突破，未来有望开启新一轮行业创新与固定资产投资周期。总体来说，全球半导体行业发展的长期前景仍然乐观。此外，新能源车、智能电网、自动驾驶

等领域的蓬勃发展，也极大地推动了硅外延、碳化硅外延等功率半导体测试设备市场的成长，为半导体测试设备行业开辟了更广阔的应用天地和市场前景。随着新应用带来的广阔市场空间和需求，半导体测试设备行业的国产化步伐将加速，国内半导体测试设备行业将因半导体产业的快速发展而受益。2024年1-9月，公司实现营业收入22,492.29万元，同比增长33.60%，业务呈现一定增长。

在此背景下，加之公司所处的半导体自动化测试系统和激光打标领域竞争激烈，为更好地完善公司的产品布局，满足未来业务规模快速增长的需求，公司需通过本项目的建设，通过投资建设固定资产和引进先进生产设备，提升半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备及其他机电一体化设备的供货能力，满足下游客户多元化的产品需求，有助于进一步提升公司的市场份额和竞争地位，持续增强公司竞争实力和盈利能力。

（2）抓住国家产业政策机遇，实现公司战略发展目标

半导体产业作为国家基础、关键和战略产业，对经济发展、科技进步和国防实力至关重要，事关国家安全和国民经济命脉。因此，国家政府高度重视半导体产业的发展，自2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将半导体产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持半导体产业发展。这些国家产业政策的出台，为本土半导体产业链的投融资、研发创新、产能扩张和人才引进等方面创造了有利条件。国家利好政策的不断出台有利于本土半导体专用设备企业进行技术创新，并将技术成果快速产业化。本项目建成后，将具备年产1,180台/套半导体自动化测试系统和340台/套激光打标及其他机电一体化设备的生产能力，能够覆盖更大功率的功率半导体和更全面的第三代半导体测试以及大规模数字和SoC类集成电路的测试，进一步提升公司在中高端半导体测试设备的技术水平，有助于实现公司未来发展战略与发展目标。

2、项目可行性

（1）公司具备多年技术积累和持续创新能力

发展至今，公司坚持创新驱动发展的战略，始终专注于半导体行业封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，在多年技术积累的基础上对主业产品进行了不断的自主创新和技术研发。公司持续进行研发投入，2024年1-9月研发投入达

8,302.29 万元，同比增长 30.57%，占营业收入比例为 36.91%；截至 2024 年 9 月末，公司共获得发明专利 41 项，实用新型专利 96 项，外观专利 14 项，软件著作权 102 项。以科技创新为要义，以高质量发展为目标，公司在核心业务领域不断完善技术布局，加快研发成果转化。

公司自成立以来持续围绕主业产品开展研发项目，始终专注于自主可控核心技术的研发。多年的技术积累使公司研发团队已掌握半导体自动化测试系统和激光打标设备及机电一体化设备的相关核心技术，并成功实现了产业化转化。公司在研发实力、研发项目及技术成果方面的持续积累，能够对公司产品的性能质量起到重要作用，从而提升公司产品在下游应用领域的市场接受度及市场竞争力。公司具备的多年技术积累和持续创新能力，将为本募投项目的顺利实施提供坚实的技术支撑。

（2）公司建立了自主可控的全流程生产管理体系

经过多年发展，公司已经建立了自主可控的全流程生产管理体系，在供应商管理、库存管理、自主生产等方面积累了丰富的经验，能够满足半导体封装测试设备行业对产品质量、库存优化、交期控制等方面的严格要求。在供应商管理上，公司制定了严格的供应商开发与评定流程，确保了供应链的稳定性和质量。公司对现有供应商进行分类管理，与大部分供应商建立了长期稳定的合作关系。库存管理方面，公司根据物料需求情况，建立了一套符合自身特点的物料采购与库存管理数据分析方法，形成了合理的安全库存模型，确保了生产的连续性和应对紧急订单的能力。在自主生产方面，公司通过多年的技术研发和生产经验积累，实现了对所有核心制造环节的自主把控，仅有少部分附加值低的零部件生产采用外协。公司通过建立全流程自主生产管理体系，减少了对外协企业的依赖，提高了产品质量的稳定性，增强了服务的响应速度，将成为项目投产后的的重要保障。

（3）公司拥有广泛的国内外客户群体和良好的市场拓展基础

在半导体自动化测试系统这一细分市场中，国际巨头依靠其技术实力和市场先发优势，长期占据主导地位。为了提高市场占有率和实现国产化替代，公司不仅需要持续提升产品性能和应用范围，还需要通过拥有专业知识的营销团队深入理解客户在封装测试环节的需求，将产品成功引入客户的产线进行验证，从而推

动销售增长。

经过多年发展，公司的业务领域覆盖华东、华南、西南、东南亚等国家和地区。公司在半导体自动化测试系统和激光打标领域积累了多年的应用经验，拥有显著的市场先发优势。公司主要客户包括安森美集团、安靠集团、长电科技、通富微电、华天科技、三安光电等半导体产业领域知名企业。公司不断积累国内外客户资源并拓展市场，随着客户结构持续优化，品牌知名度和市场影响力的不断提升，能够为项目产能消化提供良好的市场保障。

3、项目效益分析

公司“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”项目建成并达产后，将具备年产 1,180 台/套半导体自动化测试系统和 340 台/套激光打标及其他机电一体化设备的生产能力，能够覆盖更大功率的功率半导体和更全面的第三代半导体测试以及大规模数字和 SoC 类集成电路的测试，将进一步提升公司在中高端半导体测试设备的技术水平，增强公司科技创新水平和持续盈利能力，产生良好的经济效益和社会效益。

4、重新论证的结论

公司认为，“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”符合公司整体发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进该募投项目的实施。同时，公司也将密切关注外部政策环境及行业发展变化，对募集资金投资进度进行合理把控。

（二）营销服务网络建设项目

1、项目必要性

（1）提升服务品质，增强客户合作粘性

由于封测设备的专业性要求极高，且在实际应用过程中需与封装产线其他设备紧密配合，客户对于设备提供商的现场支持服务有着较大的需求，及时、专业的技术服务对于扩展业务、提升客户满意度和加强合作粘性至关重要。随着公司产品不仅在国内市场占据重要地位，更远销至东南亚等地的半导体封测企业集群地，广域覆盖的客群分布对公司服务的快速响应能力提出较高要求。

目前公司已在佛山、上海、成都、苏州、无锡等代表性市场区域建立起营销

及服务网点，确保能够覆盖华南、华东、西南等主要市场，快速响应客户需求、持续拓展当地业务。然而，目前除了总部佛山营销中心之外，公司的区域营销及服务中心规模普遍较小，且覆盖范围有限。随着公司未来业务的持续增长，仍需根据市场拓展实际情况在半导体封测企业集群地建设新的营销及服务中心，加强即时服务能力，为客户提供良好的售前及售后服务，提升公司业务洽谈的成功率以及与合作客户的粘性。

（2）高效消化产能增长，推动业务扩张

在行业周期性波动的影响下，半导体行业可能会遭遇阶段性发展放缓，但从长期来看，随着全球人工智能、高性能运算等需求的迅猛增长，AI 技术在终端应用领域的快速部署，相关产品 AI 功能及技术的持续升级，以及智能手机、个人计算机、服务器及汽车市场的需求正在复苏，加上国内半导体领域的自主创新和技术突破，未来有望开启新一轮行业创新与固定资产投资周期。总体来说，全球半导体行业发展的长期前景仍然乐观。此外，新能源车、智能电网、自动驾驶等领域的蓬勃发展，也极大地推动了硅外延、碳化硅外延等功率半导体测试设备市场的成长，为半导体测试设备行业开辟了更广阔的应用天地和市场前景。随着新应用带来的广阔市场空间和需求，半导体测试设备的国产化步伐将加速，国内半导体封装测试设备行业将因半导体产业的快速发展而受益。2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 22,492.29 万元，同比增长 33.60%，业务呈现一定增长。

在此背景下，公司需把握行业发展机遇，加速业务规模的扩张。本项目建成后，将形成对中国大陆、东南亚地区等半导体封测企业集群地全面覆盖，提高公司在半导体产业集群地的知名度，拓展当地市场。随着营销及服务网络的不断完善和营销服务团队的壮大，公司将能够有效消化未来的产能扩张，推动业务规模的快速增长。

2、项目可行性

（1）全面的技术服务支持能力为市场营销提供强有力的支持

公司所处的半导体封测设备领域具有高技术性和专业化的特点，专业的技术服务能力在公司的售前和售后环节中发挥着至关重要的作用，可迅速满足客户的需求，形成客户对公司技术服务能力的信任感，有效提高业务洽谈的成功率。

经过二十多年的发展，公司已在半导体封测设备领域积累了丰富的专业技术服务经验。公司研发投入所形成的产品和技术方案，供公司市场营销中心在营销过程中直接调用，为客户提供多元化的产品组合方案。公司凭借其专业的产品应用经验和丰富的技术方案储备，能够满足目标客户群的高技术性和专业化需求，为公司的市场营销提供了强有力的支持。

（2）丰富的产品线为业务扩张奠定坚实的基础

测试系统和激光打标设备及其他机电一体化设备是半导体封装测试环节不可或缺的生产测试设备。目前公司的产品包括功率半导体测试系统、小信号分立器件高速测试系统、集成电路测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备等。其中，功率半导体及小信号分立器件高速测试系统能够覆盖小信号分立器件、功率二极管、三极管、MOSFET、IGBT、可控硅以及第三代半导体 SiC、GaN 及功率模块的测试要求，集成电路测试系统能够覆盖模拟和数模混合信号集成电路的测试要求，激光打标设备和其他机电一体化设备能够满足封测产线器件标识打印以及封测产线配套和工艺改进的需要。一般情况下，对同一客户来说，上述设备能够满足其不同产品在封测产线上不同工艺环节的细分需求，减少客户沟通接口，提升设备整体交付能力。

此外，公司对现有产品进行持续更新迭代并积极布局研发新一代产品，主要在研项目包括大规模数字集成电路测试系统、大功率器件测试技术（第三代半导体功率器件测试技术及设备）、半导体功率器件综合测试平台（II 代）及动态测试模组、射频器件综合测试系统及相关模组、大规模数模混合信号测试系统、全自动激光打印检测系统、重力式动态测试分选系统等，公司的产品矩阵正朝着封测产线测试设备全覆盖、测试能力高端化、激光打标全自动化的方向发展，丰富的产品线能够进一步为封装测试企业客户提供更多元化的产品组合，从而提升公司在产品配套组合方案方面的市场竞争力，可有效支持公司的营销端，把握住与客户的合作机会，为公司未来业务扩张奠定坚实的基础。

3、重新论证的结论

公司认为，“营销服务网络建设项目”符合公司整体发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进该募投项目的实施。同时，公司也将密切关注外部政策环境及行业发展变化，对募集资金投资进度进行合理把控。

五、本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目内部投资结构调整及项目延期，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募投项目投向和损害公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行，是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年12月4日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》，董事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司于2024年12月4日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延

期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的审议程序。公司本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张占聪

张占聪

晏瓊

晏瓊

